公司代码:688110　　公司简称:东芯股份

东芯半导体股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析” 之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险,提请投资者注意查阅。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-30,624.97万元,母公司实现净利润-11,797.88万元,截止2023年12月31日,母公司年末可供股东分配的利润为13,706.73万元。鉴于公司2023年度实现的归属于母公司股东的净利润为负, 属于可不进行利润分配的情形。同时,结合公司的经营情况和未来资金需求,公司2023年度拟不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定:“上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算”,公司2023年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为6,480.09万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过,尚需经公司2023年年度股东大会审议通过。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	东芯股份	688110	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	蒋雨舟	黄沈檬
办公地址	上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5	上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心L4A-F5
电话	021-61369022	021-61369022
电子信箱	contact@dosilicon.com	contact@dosilicon.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

1.主要业务

公司是目前中国大陆少数能够同时提供NAND Flash、NOR Flash、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司,产品广泛应用于网络通信、监控安防、消费类电子、工业与医疗等领域。公司致力于用独立自主的知识产权、稳定的供应链体系和高可靠性的产品为客户提供高品质的存储产品及服务。公司设计研发的1xnm NAND Flash、48nm NOR Flash均为我国领先的闪存芯片工艺制程,实现了国内闪存芯片的技术突破。

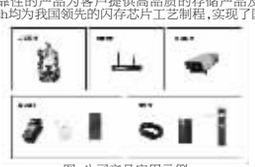


图:公司产品应用示例

2.主要产品及服务

存储芯片通过对存储介质进行电子或电荷的充放电标记不同的存储状态实现数据存储,根据断电后存储的信息是否留存分为易失性存储芯片与非易失性存储芯片。公司的主要产品为非易失性存储芯片NAND Flash、NOR Flash,易失性存储芯片DRAM 以及衍生产品MCP:

(1)NAND Flash

NAND Flash 即数据型闪存芯片,分为两大类:大容量NAND Flash 主要为MLC、TLC NAND Flash或3D NAND Flash,擦写次数从几百次至数千次,多应用于大容量数据存储;小容量NAND Flash主要是SLC NAND Flash,可靠性更高,擦写次数达到数万次以上。公司的NAND产品种类丰富,功耗低,具备高可靠性,在通讯设备、安防监控、可穿戴设备和移动终端等多个领域得到广泛应用。产品已通过联发科、瑞芯微、中兴微、博通等主流平台厂商的验证认可,主要应用于5G通讯、企业级网关、网络智能监控、数字录像机、数字机顶盒以及智能手环等终端产品。

公司聚焦平面型SLC NAND Flash的设计与研发,主要产品采用浮栅型工艺结构,存储容量覆盖512Mb至32Gb,可灵活选择SPI或PPI类型接口,搭配3.3V/1.8V两种电压,可满足客户在不同应用领域及应用场景的需求。公司 NAND Flash 产品核心技术优势明显,尤其是SPI NAND Flash,公司采用了业内领先的单颗集成技术,将存储阵列、ECC模块与接口模块统一集成在同一芯片内,有效节约了芯片面积,降低了产品成本,提高了公司产品的市场竞争力。公司产品在耐久性、数据保持特性等方面表现稳定,不仅在工业温控标准下单颗芯片擦写次数已经超过10万次,同时可在-40℃-105℃的极端环境下保持数据有效性长达10年,产品可靠性已逐步从工业级标准向车规级标准迈进。

图:公司NAND Flash产品

(2)NOR Flash

NOR Flash即代码型闪存芯片,主要用来存储代码及少量数据。其存储阵列是各存储单元通过并联方式连接组成,在实现按位快速随机读取数据的同时,允许系统直接从存储单元中读取代码执行,因此具有芯片内执行、读取速度快等特点,通常被用于存储相关数据和代码程序,来满足快速启动应用系统的需求。

公司专注于设计大容量、低功耗、ETOX工艺的SPI NOR Flash,自主设计的SPI NOR Flash存储容量覆盖64Mb至1Gb,并支持多种数据传输模式,普遍应用于可穿戴设备、移动终端等领域。

图:公司NOR Flash产品

(3)DRAM

DRAM是市场上主要的易失性存储产品之一,通过利用电容内存储电荷的有无来代表二进制比特(bit)来实现数据存储。DRAM 具有读写速度快的特点,常被用于系统硬件的运行内存,对系统中的指令和数据进行处理。

公司研发的DDR3(L)系列是可以传输双倍数据流的DRAM产品,具有高带宽、低延时等特点,在通讯设备、移动终端等领域应用广泛;公司针对移动互联网物联网的低功耗需求,自主研发的LPDDR1/2/4X系列产品具有低功耗和高传输速度等特点,最大时钟频率可达2133MHz,适用于智能终端、可穿戴设备等产品。

图:公司DRAM产品

(4)MCP

MCP产品是将非易失性代码型闪存芯片通常与易失性存储芯片搭配使用,以共同实现存储与数据处理功能。

公司的NAND MCP产品集成了自主研发的低功耗1.8v SLC NAND Flash闪存芯片与低功耗设计的DRAM,凭借设计优势已在紫光展锐、高通、联发科等平台通过认证,被广泛应用于功能手机、MIFI、通讯模块等产品。其中,DDR规格包括LPDDR1、LPDDR2和LPDDR4x,为用户提供更加灵活和丰富的选择。MCP通过将低功耗DRAM和基于NAND的技术优化结合在一起简化了走线设计,节省了组装空间,高效地集成了电路,提高了产品的稳定性。客户在使用NAND MCP产品时可以减小PCB的布板空间,降低整体系统成本,提高整体集成度和可靠性,适用于PCB布板空间狭小的应用。

图:公司MCP产品

(5)技术服务

公司拥有自主完整的知识产权,能根据客户需求定制其所需要的存储芯片定制化的设计服务和整体解决方案,帮助客户降低产品开发时间和成本,提高产品开发效率。

在为客户进行定制化产品过程中,公司不断深入了解市场需求,接收客户反馈,已经建立了“研发-转化-创新”的技术发展循环,有利于公司进一步增强技术研发实力。

(二)主要经营模式

公司作为IC设计企业,采取Fabless的经营模式,专注于集成电路设计、销售和客户服务环节,将晶圆制造、封装和测试等环节外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商。在销售环节的同时,也根据市场及客户需求提供完整的解决方案。报告期内,公司主要经营模式未发生变化。公司的整体业务流程如下图所示:

(三)所处行业情况

1.行业发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家专注存储类芯片设计的企业,聚焦中小容量的存储芯片的设计、研发及销售,致力于为客户提供多样化的存储类产品及解决方案。按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”(代码:6520),细分行业为芯片设计行业;根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。

2023年宏观经济情况仍旧复杂多变,多家主要存储芯片厂商相继推动减产计划,旨在加速市场供需平衡。随着海外大厂减产举措的逐步实施,去库存化预计将迎来加速。但公司认为随着市场对于高需求的HBM等大容量存储芯片,尤其是来自于AI大模型的需求,将推动海外大厂将更多产能投放于这类产品,从而迅速推动整个存储行业供需平衡的回归。

NOR Flash和NAND Flash都属于非易失性存储芯片,即在断电后能够保留数据。根据存储信息类型的不同,Flash可以进一步分为代码型闪存和数据型闪存。NOR Flash和SLC NAND被归类为代码型闪存,主要用于存储操作系统及其启动与运行过程中的代码信息, 对芯片的稳定性和可靠性要求较高。而MLC/TLC/QLC NAND等数据型闪存主要用于存储系统运行过程中的大容量数据信息, 对芯片的容量和成本要求较高。

NAND Flash行业集中度有所回落,但仍保持较高水平。全球NAND Flash行业前六大厂商市场份额总和逐年提高,目前 NAND 主要通过3D堆叠方式大幅提升存储容量,而堆叠层数的持续提升带来的技术难度也迅速增长。头部厂商既有深厚的技术积累也有充足的研发投入,有望率先实现更高层数,进而巩固垄断地位,进一步提升行业集中度。

与大容量NAND Flash高度垄断的市场竞争格局不同,SLC NAND市场竞争格局相对分散、参与玩家较多。三星电子、铠侠、华邦电子、旺宏电子占据了较高的市场份额,中国本土厂商有东芯股份、兆易创新、复旦微等。SLC NAND具有更快的擦写速度,常用于支持带有操作系统如Linux等复杂系统的代码存储应用。当前国外存储大厂三星电子、美光科技、海力士、铠侠正全力扩建大容量NAND产能,在 SLC NAND 的投入逐渐减少;随着海外大厂的陆续退出,留给中国本土厂商的市场空间愈发广阔;国产化需求的不断提高也带来更多的导入机会。

NOR Flash的存储阵列由各存储单元通过并联方式连接组成,实现按位快速随机读取数据的同时,允许系统直接从存储单元中读取代码执行。它具有芯片内执行(XIP)、读取速度快等特点,通常用于中小容量代码存储和快速读取,以满足快速启动应用系统的需求。

DRAM是芯片产业中产值最大的单一品类,目前全球存储器产业处于高度垄断,主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、海力士和美国的美光科技,占据全球 90%以上的市场份额,广泛应用于服务器、移动设备、PC、消费电子等领域。 近几年随着海外大厂逐步将DDR4产能转向DDR5产品并退出利基型DRAM市场,中国大陆DRAM产业技术开始起步发展。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司涵盖利基型存储芯片,包括SLC NAND Flash、NOR Flash和DRAM等产品。以丰富的产品线、可靠的性能和节能特性为支撑,公司多款代表性产品已经赢得国内外多家知名企业的认可。在产品布局、工艺制程、产品性能等方面, 公司均已经建立了相应的竞争优势。公司目前可以同时提供包括NAND Flash、NOR Flash、DRAM、MCP等主要存储芯片完整解决方案。作为中国的存储芯片设计公司,公司将持续遵循既定的发展策略和目标,主动适应不断变化的国际和市场竞争格局。依托现有的坚实基础和竞争优势,不断增加对技术和产品研发的投入,旨在提升市场份额。同时,公司将紧密关注新兴应用领域的增长潜力,以积极的姿态捕捉市场机遇,确保公司的长期稳定增长。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)SLC NAND Flash

SLC NAND Flash主流工艺制程仍然是2x-3xnm制程。近两年来,主要SLC NAND Flash厂商在2xnm制程工艺节点的产品开始逐步上市销售, 预计在未来将陆续取代38nm-40nm工艺节点产品。部分领先的SLC NAND Flash厂商正在研发 1xnm节点的制程工艺,大规模量产还需要时间。SLC NAND Flash芯片朝着降低成本和功耗、提升数据读取速度、提升可靠性等方面进行技术升级。

在传统市场因开拓迭代需求保持稳定增长的同时小容量SLC NAND Flash产品, 可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品。随着制程的不断推进,SLC NAND Flash产品将进入更多的应用领域,在网络通讯、机顶盒、可穿戴设备、智能家居等领域市场容量将进一步增加。随着网通设备、安防监控、大数据、物联网的快速发展,用户对存储芯片的容量提出了越来越高的要求,部分领域如智能穿戴产品等甚至呈现出SLC NAND Flash替代NOR Flash承担程序代码存储应用的趋势。

(2)NOR Flash

NOR Flash主流工艺制程仍然是ETOX 65nm,已成熟应用多年。近两年来,主要 NOR Flash 厂商在5xnm 工艺节点的产品开始逐步上市销售, 预计在未来将陆续取代65nm工艺节点产品。部分领先的NOR Flash厂商正在研发4xnm节点的制程工艺,大规模量产还需要时间。此外,为满足下游应用市场的需求,NOR Flash逐步朝着更低功耗、更低电压、更高性能和更大容量等技术方向发展。

尽管传统市场因需求升级而保持稳定增长,但 NOR Flash 市场规模的扩张主要受益于可穿戴设备(如TWS 耳机、智能手环、智能手表)、智能手机屏幕(AMOLED 技术)、5G基站、物联网以及新能源汽车(智能驾驶)等领域的快速发展。国内企业通过提供高性价比产品并抓住市场机遇进入市场,不断升级产品容量和工艺制程,逐渐形成各自的竞争优势,在 NOR Flash 市场上逐步取代了一些传统厂商。然而,由于国内公司主要专注于消费电子领域,而该领域市场行情受终端需求波动影响较大,因此一些头部厂商积极调整产品结构,加大对中大容量产品的研发投入,积极布局和规划工业控制、汽车电子等需求更稳定的高附加值终端应用市场,以扩大市场份额和占有率。由于汽车智能化快速发展,车规级NOR Flash的需求也在迅速增长,推动车载产品完成AEC-Q100标准测试认证,因此,进入汽车电子市场将成为NOR Flash厂商的重要发展方向。

(3)DRAM

利基型DRAM市场是作为小众、动态的成熟产品市场,现有产品规格主要包括标准的DDR3和DDR4产品以及低功耗的LPDDR1-LPDDR4x。

从需求端来看,利基型DRAM主要应用于TV、安防以及消费类电子领域;现阶段由于汽车的智能化程度尚浅,因此对DRAM的速度要求不如PC、手机和服务器,更侧重于DRAM工作状态的稳定性,因此当前车规级DRAM主要使用成熟制程进行生产。由于利基型市场下游应用领域广泛,因此行业需求的周期性波动相对较小,呈现出稳定增长的局面。随着三星、海力士、美光科技将DRAM产能向DDR5、LPDDR5x、GDDR和HBM等高容量、高毛利的产品倾斜,DRAM主流厂商的利基型产品供给将有所收缩,将留给包括大陆和台湾供应商更大的市场空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,847,165,529.16	4,322,832,330.94	4,323,587,119.28	-11.00	4,179,491,715.81	4,178,428,032.66
归属于上市公司股东的净资产	3,504,910,863.13	3,930,559,092.54	3,930,752,637.21	-10.83	3,820,029,538.44	3,820,252,676.53
营业收入	530,588,242.52	1,146,000,876.64	1,146,000,876.64	-53.70	1,134,281,270.31	1,134,281,270.31
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	529,088,252.94	1,144,443,230.67	1,144,443,230.67	-53.77	1,133,442,288.96	1,133,442,288.96
归属于上市公司股东的净利润	-306,249,693.71	185,461,824.56	185,432,231.24	-265.13	261,571,804.35	261,796,151.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-326,691,659.75	164,885,941.49	164,856,348.17	-298.13	255,041,793.42	255,266,140.57
经营活动产生的现金流量净额	-301,755,851.65	-261,017,608.56	-261,017,608.56	不适用	117,522,087.87	117,522,087.87
加权平均净资产收益率(%)	-8.20	4.74	4.74	减少12.94个百分点	29.47	29.49
基本每股收益(元/股)	-0.69	0.42	0.42	-264.29	0.77	0.77
稀释每股收益(元/股)	-0.69	0.42	0.42	-264.29	0.77	0.77
研发投入占营业收入的比例(%)	34.34	9.63	9.63	增加24.71个百分点	6.60	6.60

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	123,835,909.21	115,806,011.12	131,490,811.57	159,455,510.62
归属于上市公司股东的净利润	-34,367,269.67	-40,740,184.38	-71,191,694.25	-159,950,545.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-37,582,685.36	-43,394,170.88	-76,352,007.53	-169,362,795.98
经营活动产生的现金流量净额	-32,992,856.62	-84,731,040.25	-113,695,594.38	-70,336,360.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,589
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,510
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东方恒信集团有限公司	0	143,213,025	32.38	143,213,025	无	0	境内非国有法人
苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)	0	22,500,000	5.09	22,500,000	无	0	其他
哈勃科技创业投资有限公司	0	13,267,493	3.00	0	无	0	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	11,509,967	11,509,967	2.60	0	无	0	其他
齐亮	-18,217,731	7,752,444	1.75	0	质押	6,000,000	境内自然人
珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙)	-13,021,211	6,456,885	1.46	0	无	0	其他
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	4,928,041	4,928,041	1.11	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	4,903,608	4,903,608	1.11	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-广发成长精选混合型证券投资基金	4,541,352	4,541,352	1.03	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶恒瑞八号私募证券投资基金	690,185	4,325,555	0.98	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人东方海峡资本管理有限公司为东方恒信集团有限公司的控股子公司。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

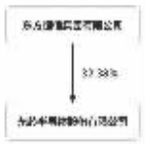
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

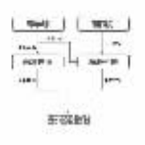
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内, 公司实现营业收入53,058.82万元, 较上年同期减少53.70%; 归属于上市公司股东的净利润-30,624.97万元,较上年同期减少265.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,669.17万元,较上年同期减少298.13%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的, 应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688110证券简称:东芯股份公告编号:2024-027

东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议的通知已于2024年4月8日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)及制定、修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2024-013)及《东芯半导体股份有限公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订(对外投资管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订(对外担保管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订(规范与关联方资金往来管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于修订(董事会战略委员会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

18、审议通过《关于修订(内部控制制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

19、审议通过《关于修订(财务管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

20、审议通过《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

21、审议通过《关于修订(董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

22、审议通过《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

23、审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记备案制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

24、审议通过《关于修订(子公司管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

25、审议通过《关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

26、审议通过《关于制定(信息披露暂缓与豁免业务管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上,上述子议案25已经董事会审计委员会审议通过,子议案1-9尚需提交公司股东大会审议通过。以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订(公司章程)及制定、修订部分内部治理制度的公告》(公告编号:2024-013)。

(三)审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

(六)审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

(七)审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-014)。

(八)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(九)审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度内部控制评价报告》。

(十二)审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-017)。

(十三)审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-018)。

(十四)审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-020)。

(十六)审议通过《关于2024年度申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-021)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)审议《关于公司董事2023年度薪酬确认与2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并全体回避表决。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,9票回避。基于谨慎性原则,全体董事回避表决本议案。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认与2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-022)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认与2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员谢莺霞已回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。关联董事谢莺霞、蒋雨舟已回避表决本议案。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认与2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-022)。

(二十)审议通过《关于作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《东芯半导体股份有限公司2022年限制性股票激励计划 (草案)》《东芯半导体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《东芯半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》《东芯半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2022年第二次临时股东大会、2022年年度股东大会的授权, 董事会同意作废公司2022年限制性股票激励计划48.738万股限制性股票以及作废公司2023年限制性股票激励计划244.22万股限制性股票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员谢莺霞已回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事蒋学明、谢莺霞、蒋雨舟已回避表决本议案。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于作废2022年及2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-023)。

(二十一)审议通过《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全有效的激励约束机制,充分调动公司核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合,使各方共同关注公司的可持续发展,在充分保障股东利益的前提下, 按照收益与贡献对等的原则, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,公司制定了《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,向激励对象实施限制性股票激励计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员谢莺霞已回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事蒋学明、谢莺霞、蒋雨舟已回避表决本议案。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-024)、《2024年限制性股票激励计划(草案)》)。

本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(二十二)审议通过《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

为了保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,公司制定了《东芯半导体股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员谢莺霞已回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事蒋学明、谢莺霞、蒋雨舟已回避表决本议案。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(二十三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关的事项,包括但不限于:

1、授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件,确定本次激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股